

## 2011年3月期 第1四半期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2010年7月29日

代表取締役社長 赤尾 泰

© 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

00000-A

本日はご多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。

2011年3月期第1四半期の決算概要について  
ご説明いたします。

(本プレゼンテーションに関する注意)

本資料における前連結会計年度(2010年3月期)の業績数値は、旧NECエレクトロニクス(株)と旧(株)ルネサス テクノロジーの前連結会計年度の業績数値を単純合算したものであります。なお、「売上高」および「半導体売上高」については、旧NECエレクトロニクス(株)の表示方法と整合させるために旧(株)ルネサス テクノロジーについて一部組替表示しております。

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与える重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因があります。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

## エグゼクティブサマリー

### I. 2011年3月期 第1四半期決算概要

- 統合ベースで、売上高は前四半期比較で100億円の増収達成。  
営業益はほぼ均衡圏へ
- 当期純損益には、構造対策費用(固定資産減損等)を計上

### II. 2011年3月期通期業績見通し

- 売上増加、構造対策等により、統合コストを吸収し、通期は営業黒字確保の見込み
- 当期純損益は、構造対策費用の計上により800億円の損失見込み

### III. 100日プロジェクトの検討結果と実行プラン

### IV. まとめ

こちらが本日のご説明内容の表題でございます。

まず、2011年3月期 第1四半期の業績につきましては、売上高は前四半期比で約100億円の増収となりました。営業損益は、ほぼ均衡圏に回復いたしました。

次に2011年3月期通期の見通しでございますが、売上高の増加、構造対策の実施などにより、通期で、発足時の経営目標である初年度の営業黒字を確保いたします。一方、当期純損益につきましては、構造対策費用の計上により、800億円の損失を見込んでおります。

最後に、皆様に100日プロジェクトの検討結果および実行プランについてご報告いたします。

## 2011年3月期 第1四半期決算概要

4 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

それでは、スライドに沿ってご説明してまいります。

2011年3月期第1四半期 決算概要でございます。

## 第1四半期(4-6月期)決算概要

- 第1四半期は、前四半期比売上増4%
- 営業損益は大幅改善、統合コストを除く実力ベースでは黒字浮上
- 当期純損益は、固定資産の減損などにより大幅損失

(単位：億円)	2010年3月期		2011年3月期		
	第1四半期	第4四半期	第1四半期	前年同期比	前四半期比
売上高	2,353	2,817	2,920	+567	+104
半導体売上高	2,087	2,517	2,615	+527	+98
営業損益	△439	△127	△3	+436	+123
経常損益	△450	△162	△35	+415	+127
当期純損益	△445	△176	△331	+114	△155
1US\$=	-	-	92円	-	-
1ユーロ=	-	-	121円	-	-

まず、実績のサマリでございます。

第1四半期の半導体売上高は、前四半期との比較で98億円増の2,615億円となりました。

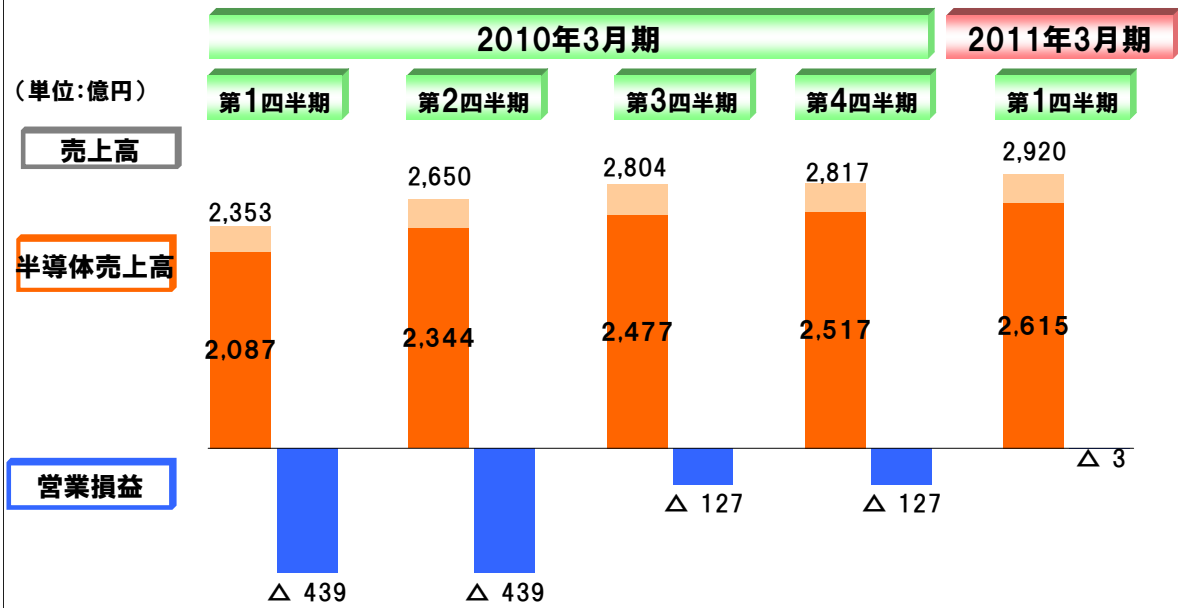
営業損益は3億円の損失で、前四半期比では123億円改善となりました。

経常損益は、35億円の損失となりました。

当期純損益は、固定資産の減損の計上等により331億円の損失となりました。

## 四半期別業績推移

■ 第1四半期は、売上高、営業損益ともに改善



次に、四半期ごとの業績でございますが、第1四半期は、売上高、営業損益ともに改善となりました。

## 第1四半期半導体売上高(前年同期比、前四半期比)

- 第4四半期から4%増収
- マイコンは、中国市場を中心とする新興国で増収

2011年3月期					
(単位:億円)	第1四半期	前年同期比(%)	前四半期比(%)		
<b>半導体売上高</b>	2,615	+25%	+4%	<b>事業別売上概況(前四半期比)</b>	
<b>SoC</b>	777	△3%	△4%	<b>SoC</b> 【↓】: PC周辺、民生機器分野を中心に減収	
<b>マイコン</b>	993	+42%	+6%	<b>マイコン</b> 【↑】: 自動車向け、汎用ともに増収	
<b>アナログ&amp;パワー半導体</b>	826	+45%	+9%	<b>アナログ&amp;パワー半導体</b> 【↑】: 全般的に増収	
<b>その他半導体</b>	18	△17%	+101%		

7 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

7ページは第1四半期の事業別の半導体売上高についてお示ししています。

前年度の第4四半期と比較して、半導体売上高は4%の増収、事業別では、マイコン、A&P半導体で増収となった一方、SoCは減収となりました。

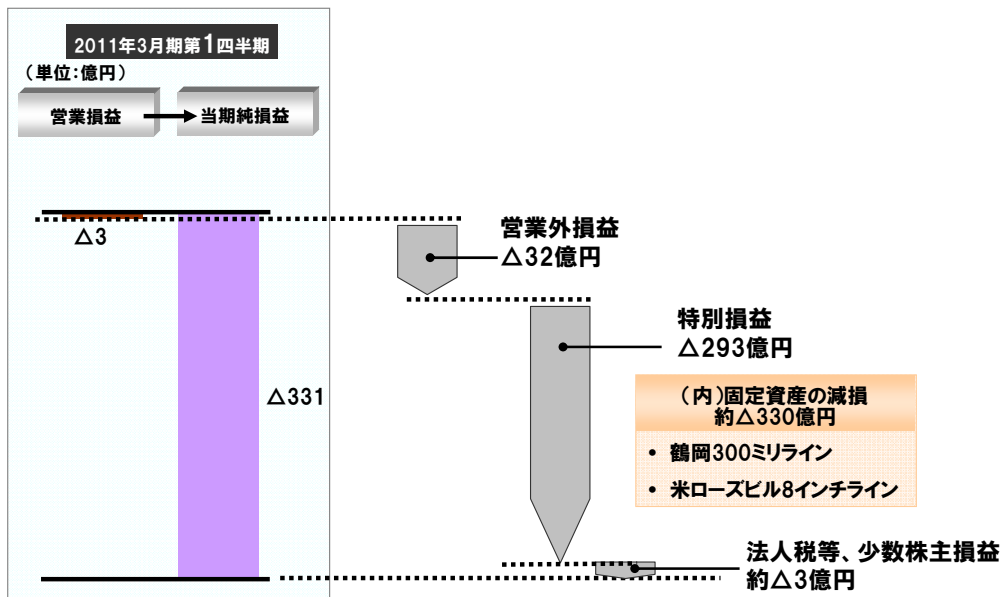
事業別に見ますと、SoCにおいては、PC周辺機器や民生機器向けのシステムLSIが減収となりました。

マイコンにおいては、自動車向け、汎用ともに堅調に推移、

A&P半導体においても、パワー半導体を筆頭に、全般的に堅調な売上となりました。

## 第1四半期 当期純損益概況(営業損益からの推移)

■ 営業損益は前四半期比大幅改善したものの、固定資産の減損を計上したことにより、第1四半期の当期純損益は大幅な損失。



8 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

8ページは、第1四半期の当期純損益概況をお示したものです。

第1四半期は、  
営業外損益として32億円の損失、  
特別損益として293億円の損失を計上いたしました。

特別損益のうち、鶴岡300ミリラインおよび米国ローズビル8インチラインの減損を行った結果、固定資産の減損として約330億円の特別損失を計上いたしました。

結果として、第1四半期の当期純損益は331億円の損失となりました。

# バランスシート

(単位:億円)

	10/4期首 (増資後)	10/6末
<b>総資産</b>	12,154	11,510
うち 現金及び現金同等物	3,377	3,186
うち たな卸資産	1,266	1,307
<b>負債合計</b>	8,017	7,775
うち 有利子負債	3,720	3,754
<b>株主資本</b>	4,210	3,880
<b>純資産合計</b>	4,136	3,735
<b>D/Eレシオ(グロス)</b>	0.91倍	1.02倍
<b>D/Eレシオ(Net)</b>	0.08倍	0.15倍
<b>自己資本比率</b>	33.5%	31.9%

(注1)①現金及び現金同等物:「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3か月を超える定期預金」を控除しております。  
 ②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「新株予約権付社債」、「長期借入金」  
 ③自己資本:「株主資本」、「評価・換算差額等」  
 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本  
 ⑤10/4期首(増資後)の負債合計には、負のれん22億円を便宜的に含めております。  
 (注2)「10/4期首(増資後)」の数値は、当連結会計年度期首の数値に2010年4月1日付の企業結合に係る会計処理および同日付の第三者割当増資約1,346億円を反映した数値です。

9ページは、バランスシートでございます。

左の列にお示ししている数値は、合併後の期首バランスシートに、合併直後に実施した第三者割当増資を加味したものととなります。

増資後のバランスシートは、有利子負債が約3,700億円、株主資本が約4,200億円、であり、D/Eレシオは0.91倍と1倍以下、自己資本比率は約33%となりました。

6月末のバランスシートは、当期純損失の計上などにより株主資本が減少いたしました。

## キャッシュ・フロー

(単位：億円)

	2010年3月期			2011年3月期
	第1四半期	第4四半期	年度計	第1四半期
営業活動による キャッシュ・フロー	△406	168	246	△20
投資活動による キャッシュ・フロー	△240	△212	△768	△144
フリー・ キャッシュ・フロー	△647	△43	△523	△164

10ページは、キャッシュ・フローでございます。

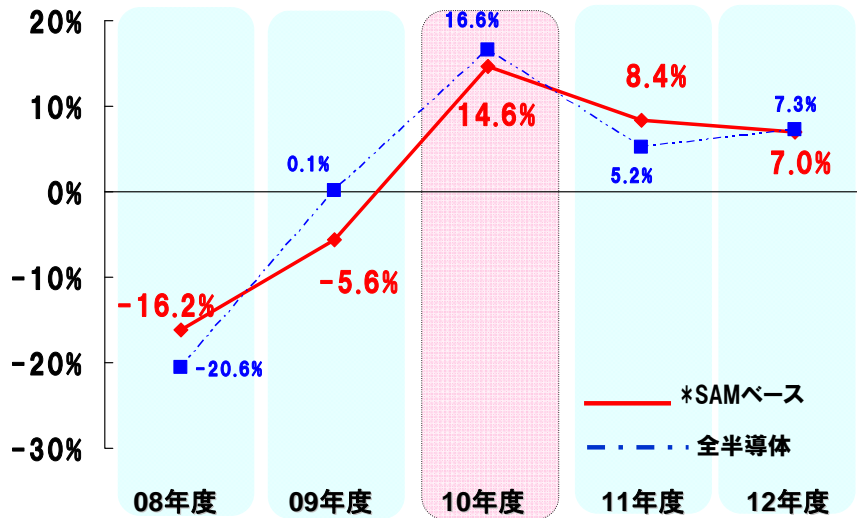
当期純損失を計上したことや、たな卸資産が増加したこと、また、第1四半期に訴訟等関連損失の支払いが発生したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローが若干の赤字となりました。

## 2011年3月期 通期業績見通し

次に2011年3月期 通期業績の見通しについてご説明いたします。

## 半導体市場動向

半導体市場(対前年伸び率)推移(円ベース)



\*SAM:全半導体からDRAM, MPU, Flash, Sensorを除いた市場  
出典:WSTS,ルネサスエレクトロニクス

12ページは、半導体市場の動向についてお示ししております。

今年度につきましては、半導体市場の成長が加速し、**16.6%**の市場成長率となる見込みです。また、当社の対象とする市場におきましても、期初の見通しから約**3**ポイント上昇の**14.6%**の市場成長を見込んでおります。

## 2011年3月期 通期業績見通し

- 通期営業黒字化を見込む。
- 当期純損益については100日プロジェクトにおける構造対策推進等による特別損失770億円の計上を見込み、大幅赤字の見通し

(単位：億円)	2010年3月期			2011年3月期見通し			
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	前年比
<b>売上高</b>	5,003	5,621	10,624	5,900	6,000	11,900	+1,276
<b>半導体売上高</b>	4,431	4,994	9,425	5,400	5,500	10,900	+1,475
<b>営業損益</b>	△879	△254	△1,133	△20	90	70	+1,202
<b>経常損益</b>	△934	△320	△1,253	△80	30	△50	+1,203
<b>当期純損益</b>	△992	△385	△1,378	△420	△380	△800	+577
1US\$=				90円			
1ユーロ=				110円			

13 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

13ページは、2011年3月期 通期の業績見通しでございます。

堅調な市況環境をふまえ、

半導体売上高見通しは1兆900億円とし、5月11日の見通しより200億円を上積みしました。

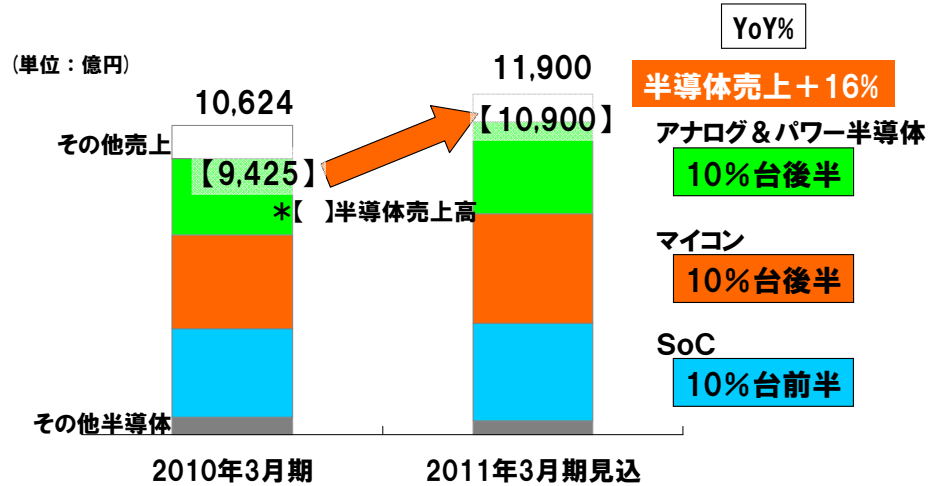
営業損益は70億円の利益、

経常損益は50億円の損失を見込んでおります。

当期純損益につきましては、100日プロジェクトにおける構造対策の推進等により、特別損失を約770億円計上する見込みであり、通期の当期損失は800億円となる見通しです。

## 2011年3月期売上高見通し

- 製品ポートフォリオの再構築によるディスシナジー効果を吸収して、市場以上の成長を達成する見込み
- 足元の好調さを反映し、5月時点から売上高見通しを200億円上方修正
- 海外市場向け売上高の拡大



14ページは、当社の今年度売上見通しでございます。

半導体売上高は、製品ポートフォリオの再構築によるディスシナジーが想定されるものの、市場成長率を上回る16パーセントの増収を見込んでおります。

前ページでもお話ししましたとおり、半導体市場は足元好調であり、5月発表時の見通しから200億円上方修正の1兆900億円といたしました。

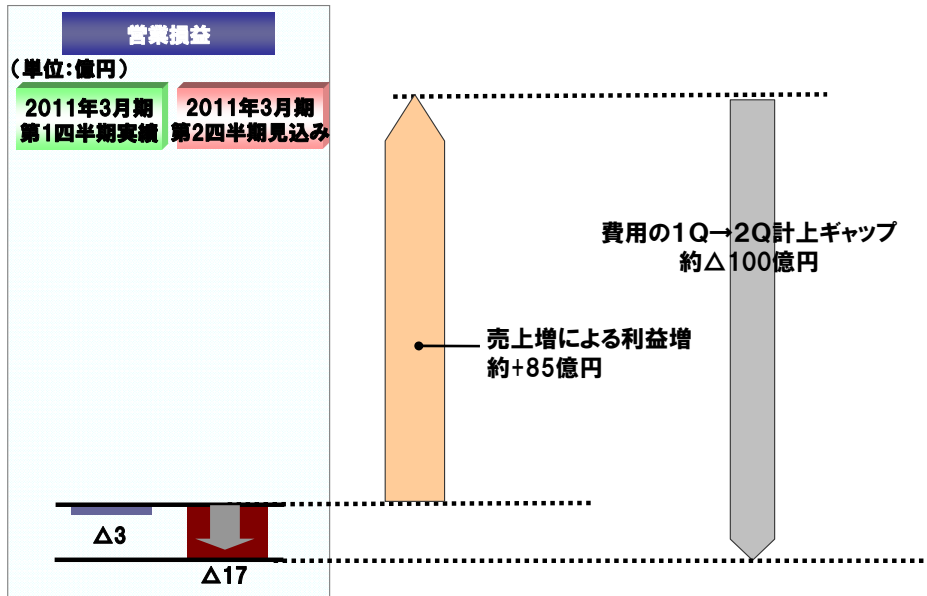
また、それぞれの事業において、海外市場向け売上高を拡大してまいります。

事業別に見ますと、

SoCは、自動車のマルチメディア向けLSIを中心に10パーセント前半の増収、マイコンは、自動車向け、汎用向けとも堅調に伸び、10パーセント台後半の増収、A&P半導体は、アナログICやパワーデバイスで強い成長を見込んでおり、10パーセント台後半の増収を想定しております。

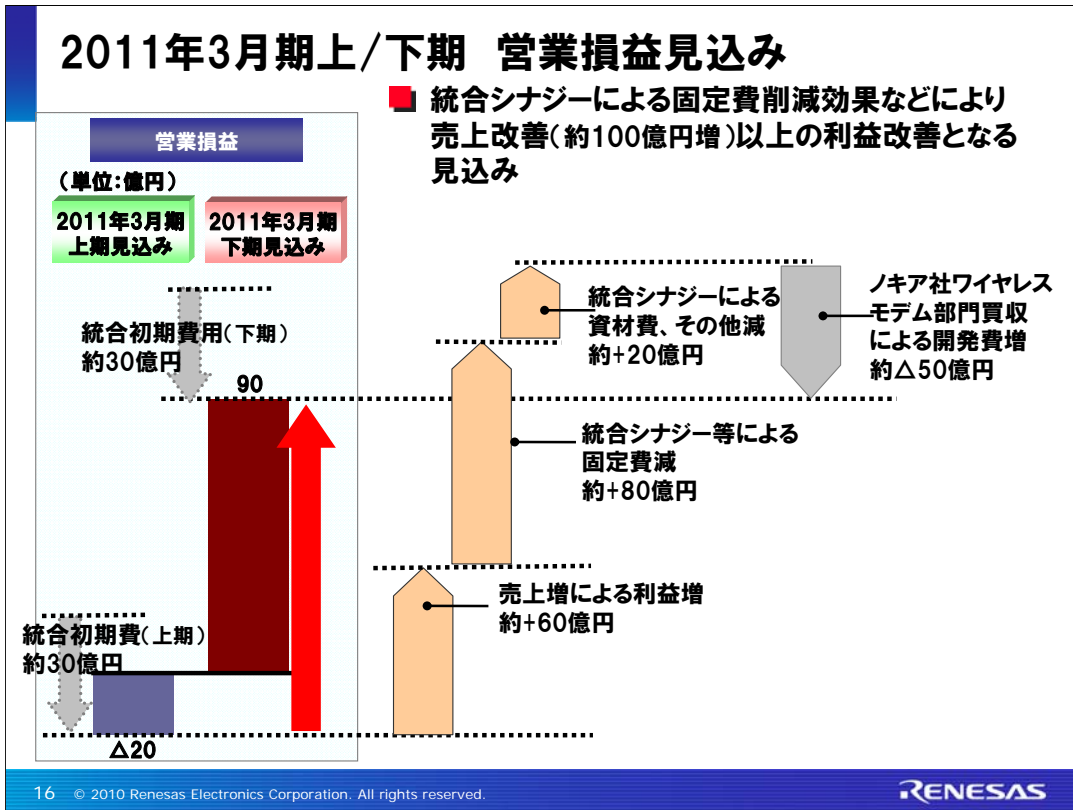
## 2011年3月期 第2四半期営業損益見込み

- 売上増による利益増が見込まれるものの、費用が通常期末に集中することにより、営業赤字を見込む



15ページは、第2四半期の営業損益見込みを示したものです。

第2四半期の営業損失は、約17億円を見込んでおります。  
第1四半期比で売上高の増収による利益増を見込んでいるものの、  
通常のコストの計上が期末に集中することなどにより、  
営業赤字を見込んでおります。



16ページは、上期から下期の営業損益の改善見込みについてお示しております。上期から下期にかけて、約100億円の売上改善を見込んでおりますが、統合シナジー効果などにより、売上増以上の利益増となる見通しです。

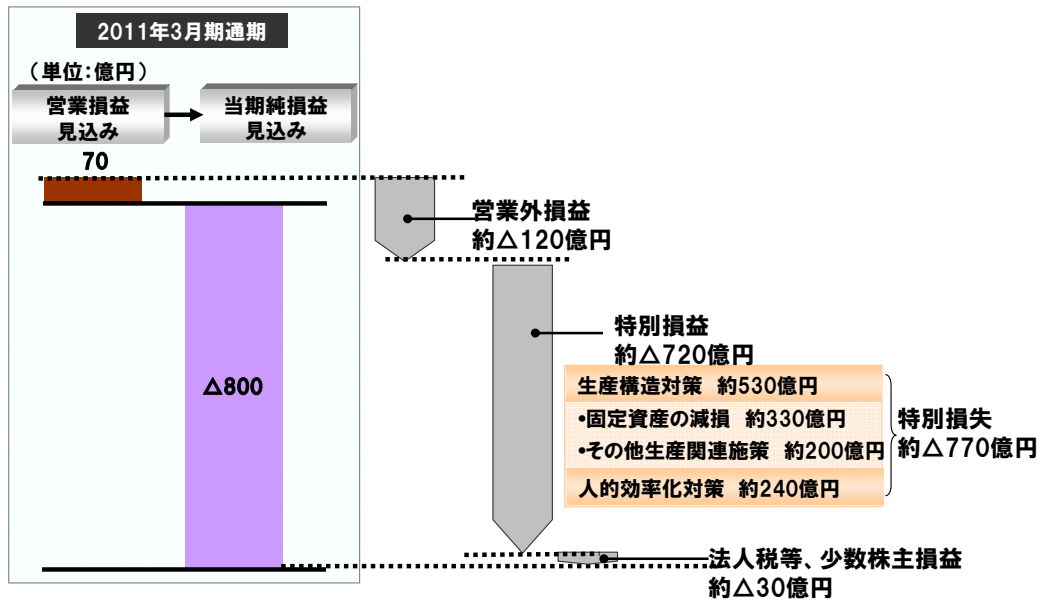
具体的には、売上増による利益増に加え、統合シナジーなどによる固定費減、統合シナジーによる資材費減などが挙げられます。

一方で、ノキア社のワイヤレスモデム事業を買収したことにより、上期から下期にかけて固定費が約50億円増加する見込みです。

尚、統合初期費用の影響を除くと、上期も営業黒字となる想定です。

## 2011年3月期 当期純損益見込み(営業損益からの推移)

■ 統合初年度に抜本的な構造対策を決定・実行し、通期で約770億円の特別損失を計画



17 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

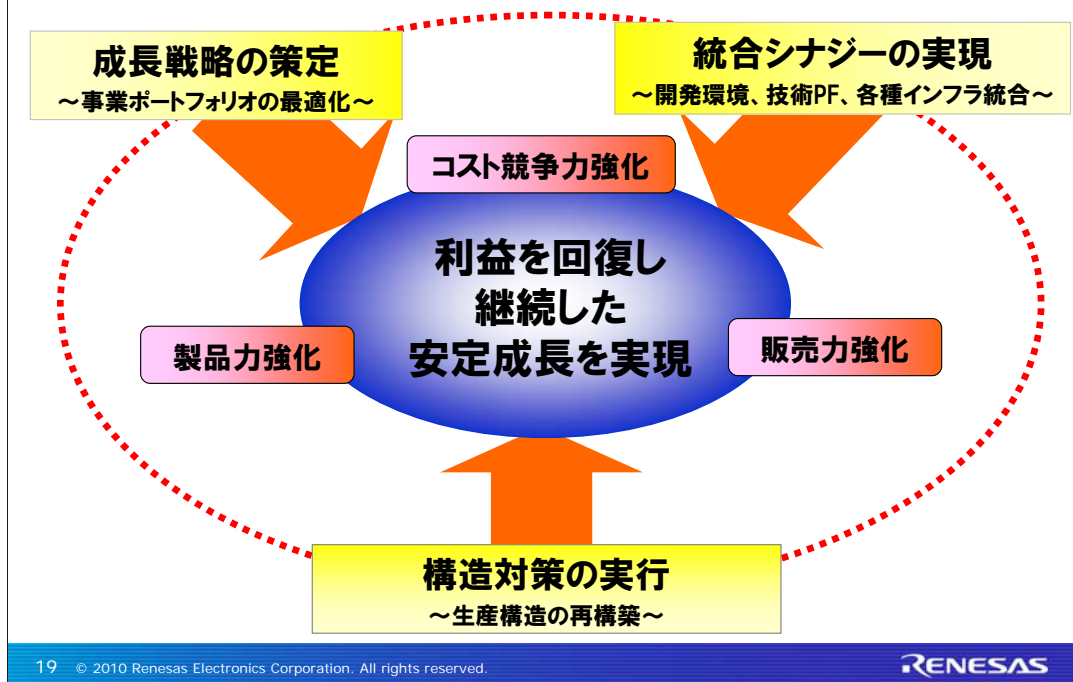
17ページは、通期の当期純損益見通しについてお示しております。  
今年度は営業利益として70億円を見込んでおりますが、  
営業外損益として約120億円の損失、  
特別損益として、約720億円の損失  
を想定しております。

特別損益720億円の損失のうち、  
生産構造対策費用で約530億円、人的効率化で約240億円、  
合計で特別損失として約770億円を想定しております。

### III. 100日プロジェクトの検討結果と実行プラン

次に100日プロジェクトの検討結果および実行プランについてご報告いたします。

## 「100日プロジェクト」の概要



まずは100日プロジェクトの概念でございます。

100日プロジェクトにおいては、

製品力、販売力、コスト競争力を強化し、利益回復および継続した安定成長を実現できる事業基盤を構築するため、大きく3つの観点から経営課題を議論いたしました。

まず、成長戦略の策定として、事業ポートフォリオの最適化を推進し、継続した売上成長を実現できる事業基盤の構築に向けた成長戦略を各事業ごとに策定いたしました。

つぎに、統合シナジーの実現として、開発環境や技術プラットフォーム、各種インフラの統合を推進し、合併により創出できる費用効果を明確にいたしました。

3つめに、構造対策の実行として、市況変動に耐性があり、安定的な利益を確保できる構造対策プランを策定いたしました。

## 「100日プロジェクト」の効果のまとめ

### 目標

#### 成長戦略の策定

12年度までの売上成長率：  
10年度から7%~10%年平均成長

#### 統合シナジーの実現

10年度~12年度累計  
約400億円のシナジー効果創出

#### 構造対策の実行

10年度~12年度累計  
約700億円の費用抑制効果

次に、100日プロジェクトにて策定した大きな3つの施策によって達成できる効果のまとめでございます。

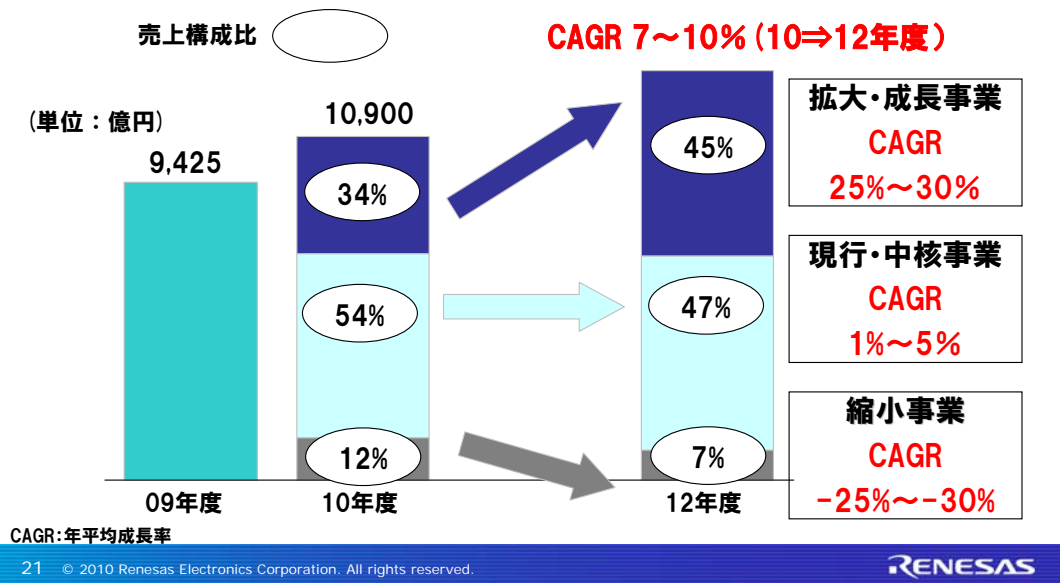
まず、成長戦略の策定におきましては、製品ポートフォリオの最適化等をおこない、10年度から12年度で、7パーセントから10パーセントの年平均成長を目標といたします。

総合シナジーの実現につきましては、各種システム、技術基盤、インフラ等の統合を推進し、10年度から12年度の累計で約400億円のシナジー効果を想定しております。

構造対策の実行につきましては、生産構造対策、人的効率化を推進することにより、10年度から12年度で累計約700億円の費用抑制効果を見込んでおります。

## 半導体売上計画

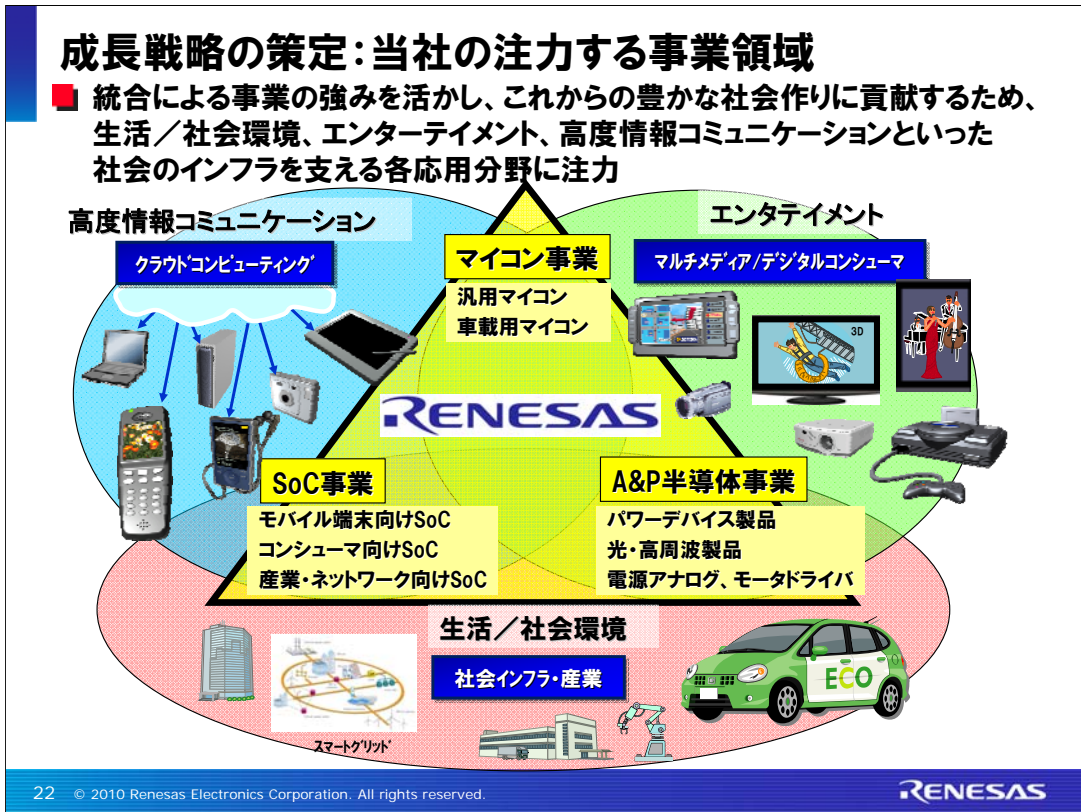
- 事業ポートフォリオの最適化により拡大・成長事業にリソースを集中
- 拡大・成長事業を柱に12年度に10年度比年平均7~10%成長を実現
- 現行・中核事業は効率化をはかりコスト競争力を強化



21ページは、10年度から12年度の半導体売上計画です。

まず、事業ポートフォリオの最適化をおこなうことにより、拡大・成長事業にリソースを集中し、12年度には10年度比で年平均7パーセントから10パーセントの売上成長を実現いたします。

また、現行・中核事業においては、徹底した効率化をはかることにより、コスト競争力を強化し、確実な収益基盤となる事業として維持してまいります。



22ページは、成長戦略の策定の前提となる、ルネサスの注力する事業領域についてご説明いたします。

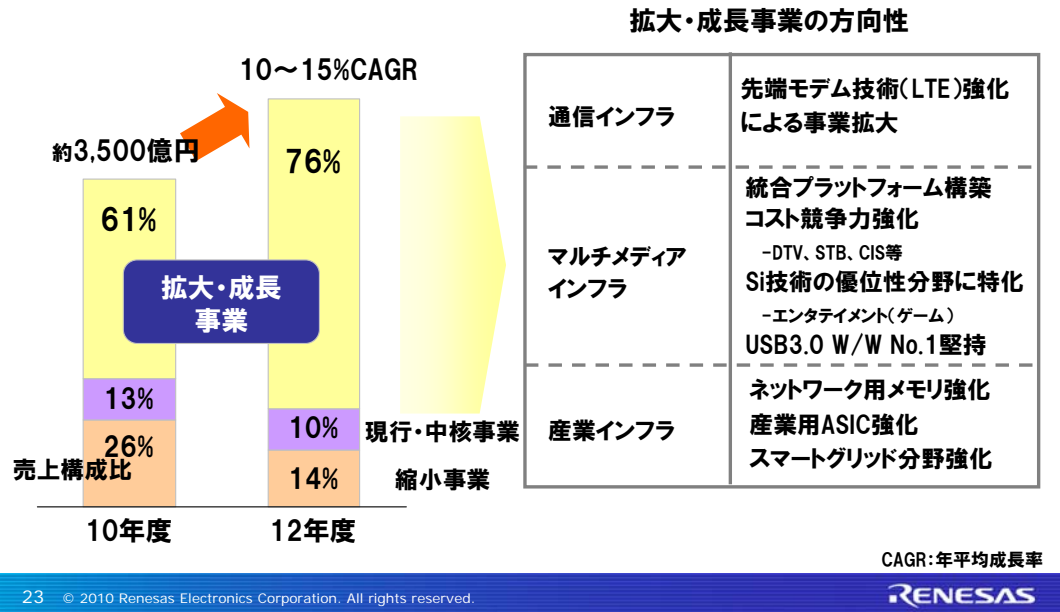
当社は生活・社会環境、エンターテインメントや高度情報コミュニケーションにおける電子機器の応用分野である社会インフラ・産業、マルチメディア/デジタルコンシューマーやクラウドコンピューティング分野などを当社の事業領域と位置づけ、既に市場にてある程度のシェアを持つ強い製品、また統合シナジーや製品事業間の連携により強化していく製品を、本領域に注力投入していきます。

今回の100日プロジェクトの中の成長戦略の策定として各製品事業部門について、継続的な安定成長を目的とした事業ポートフォリオの最適化を行いました。

次項から当社の製品事業部門における拡大・成長戦略について説明いたします。

## 成長戦略の策定:SoC事業

■ 様々な分野にまたがって拡大成長が見込まれ且つ総合力を有する当社の強みを発揮できる“インフラ”事業に集中



はじめに、SoC事業の成長戦略についてご説明いたします。

事業ポートフォリオの最適化として、まずSoC事業を拡大成長、現行維持・中核、縮小事業に客観的な指標、つまり市場成長性や売上規模、当社技術に優位性があるもので分けました。

SoC事業全体の約60%の部分を拡大・成長事業と位置づけ、12年度には売上ベース比率で10年度比約15%増を目標とします。

この拡大・成長事業の方向性として、まず、全ての分野に今後共通して使われていくであろう、技術的な基盤、例えば通信モデム技術など、を“インフラ”事業と定義付け、総合力を有する当社の強みを発揮できる市場へ注力します。

そしてこの注力市場の中で、当社の優位性技術のある、LTE/HSPA+対応の通信モデム技術やeDRAM等のSi技術、スマートグリッド向けSoCを中心に事業拡大をはかり、10年度から12年度にかけて年平均で2桁成長を実現します。

## 成長戦略の策定:SoC事業 通信インフラ強化(1)

～ノキア社の通信モデム部門買収

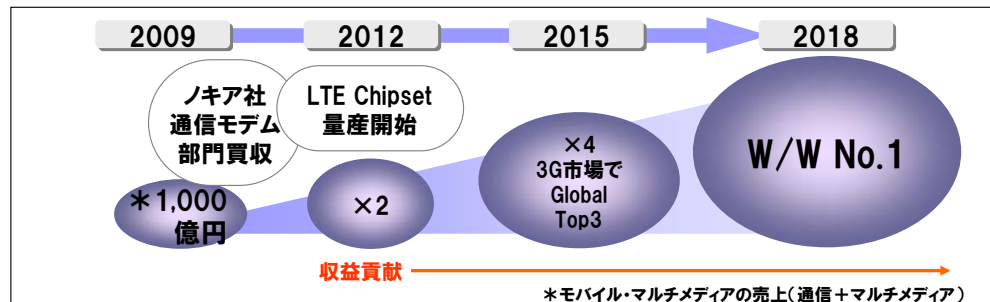
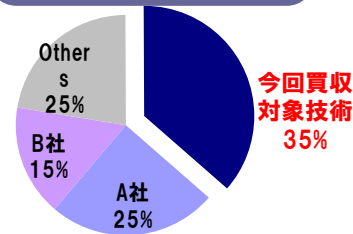
### ■ 買収技術のメリット

- >長期の蓄積が必要な特殊なIP
- >W/W No.1 シェア
- >過去数十億台に渡る採用実績
- >200社以上のオペレータとの接続検証済み

### ■ 通信インフラ事業の目標

- >世界トップのモバイルプラットフォームベンダーを目指す

W/W 3Gモデム技術シェア



24 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

24ページは、SoC事業の中で拡大・成長の核となる通信インフラ強化についてお示ししております。今月7月6日にノキア社の通信モデム事業部門を買収することを決定しその旨を発表いたしました。

本事業譲渡の背景としましては、ユーザーインターフェースやハードに注力したいノキア社と通信モデム技術を獲得し、世界で通用するモバイルプラットフォーム全体を提供し事業拡大を図りたい当社との間で、方向性が合致し本事業譲渡に至りました。

買収技術のメリットとしましては、やはりW/WNO.1の3Gの技術シェアを誇り、世界で200社以上の通信ネットワークオペレータとの接続検証が済んでいるなど、競合他社の参入障壁が非常に高い特殊な通信技術IPを獲得できたことです。

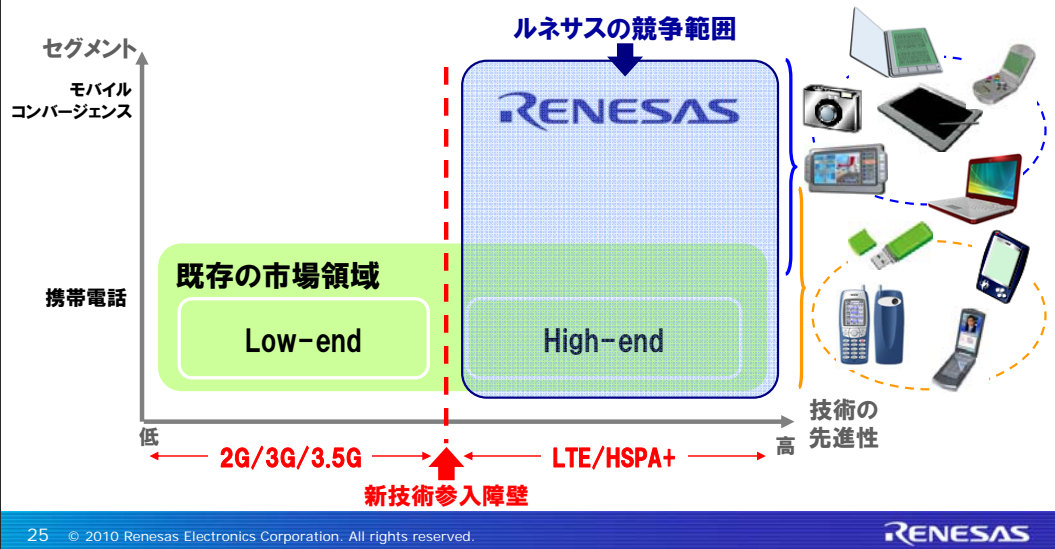
当社はこの通信モデム技術を生かし、既存の当社のアプリケーションプロセッサや高周波製品と組み合わせ、携帯電話市場のみならず、携帯情報端末やメディアコンバージェンス市場へモバイルプラットフォームを提供してまいります。

ここでは本買収のみの売上高ではなく、通信インフラ事業全体の売上でお示しておりますが、現状約1000億円の売上規模を2年で約2倍、5年で約4倍に増やしていく計画です。

## 成長戦略の策定: SoC事業 通信インフラ強化(2)

～当社の強み

- >ネットワーク市場:幅広いマイコン顧客との関係  
⇒モバイルコンバージェンス市場に競合との優位性あり
- >モデム技術獲得により、プラットフォーム開発力・サポート力強化



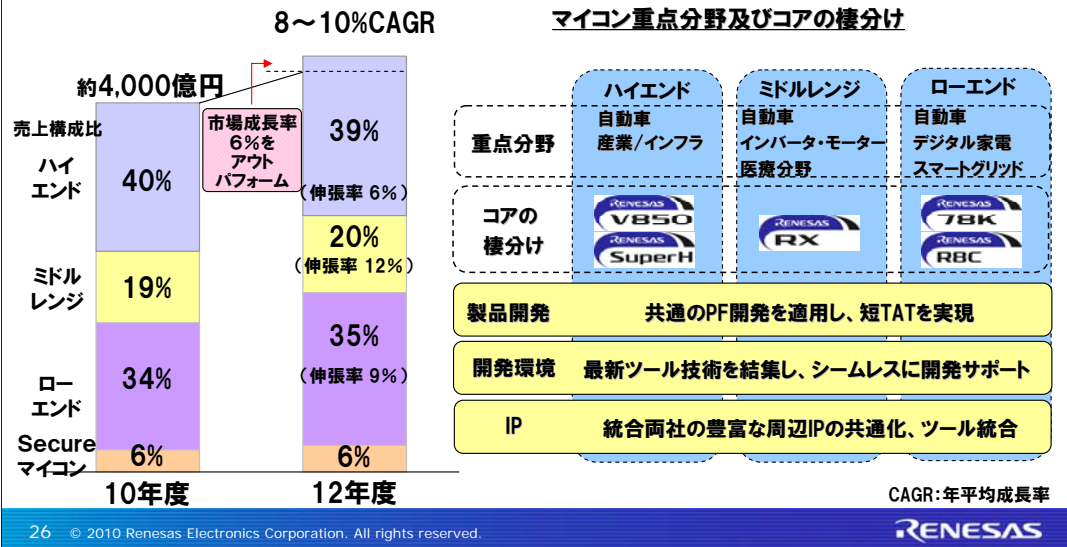
25ページは、LTE/HSPA+によってどのように通信分野市場が変化するかをお示ししたものです。これまでの携帯電話を中心とした市場からパソコン、デジタル家電または自動車までも巻き込んだモバイルコンバージェンスが加速します。

図に示しました通り、当社の事業領域は既存のハイエンドの携帯電話市場部分のみならずモバイルコンバージェンス市場にまで拡大します。

このモバイルコンバージェンス市場に対して、当社がこれまであらゆる電子機器にマイコンを中心とする製品を提供し、社内に蓄積してきたシステムノウハウや顧客との信頼関係をこの当社の通信モデム技術を生かした新たなモバイルプラットフォームと融合することで、当社には競合他社に真似のできない優位性があると考えています。

## 成長戦略の策定:マイコン事業 安定成長の実現

- 旧NECエレクトロニクスと旧ルネサステクノロジーの強みを結集し、市場成長率を上回る伸びで、安定成長の実現を目指す
- 統合によって生み出した経営資源により、新市場(中国)、重点市場への取組みを強化
- 次世代統合プラットフォーム環境を構築し、短TAT、豊富なIPを武器にダントツW/WNO.1シェアを確立



次にマイコン事業についての成長戦略を説明いたします。

マイコン事業として当社は09年度統合2社合算でW/WNO.1の約30%のマイコンにおけるシェアを持っており、如何にこのポジションをより強固なものにし、かつ市場成長以上の売上成長を図るかが課題でした。

まず、マイコン市場をハイエンド、ミドルレンジ、ローエンドに分類し、その中に更に市場性、当社の優位性の観点から、重点分野をそれぞれ設定しました。

設定したそれぞれの重点分野において、顧客ソフト資産の観点から当社のコアを一本化するのではなくそれぞれの分野において優位性のあるコアを割当てました。

その上で、当社マイコン製品全体における製品開発、開発環境やIPを統合又は一本化することにより、統合による開発のダブリやディスシナジーを最小限にとどめると共に、共通化で捻出したリソースを重点分野に振り向け売上拡大を図ります。

## 成長戦略の策定:マイコン事業 中国事業戦略

■ 市場環境変化に即応し、現地で意思決定する体制によりビジネス成果の最大化をはかる

### 【中国市場環境の変化】

- 政府主導 ⇒ 社会インフラの拡充 ・ 省エネの推進
- 所得水準の向上 ⇒ 急速な車の普及 ・ 住居環境の改善

### 【市場環境の変化に即応できる体制の強化を推進】

- 現地ローカルTOPで10月1日から発足
- 上海に拠点設置、マーケティングから販売まで:約150名体制
- 中国の設計力を強化:現在600名 ⇒ 順次拡大、3年間で1,000製品を市場に投入

### 【市場環境の変化に対応したターゲットセグメントの決定】

~2012年度投入  
予定製品数

<b>社会インフラの充実</b> 電力メータ(スマートグリッドの地域展開加速) 水道、ガスメータ	<b>実績NO.1</b> 100	<b>急速な自動車の普及</b> ボディ、ダッシュボード、e-Bike	<b>実績NO.1</b> 100
<b>省エネの推進</b> インバータ家電(エアコン・冷蔵庫・洗濯機)、 LED照明	<b>実績NO.1</b> 600	<b>住居環境の改善</b> ホームセキュリティ他	<b>実績NO.1</b> 200

27 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

27ページでは、マイコン事業における中国事業戦略について説明いたします。

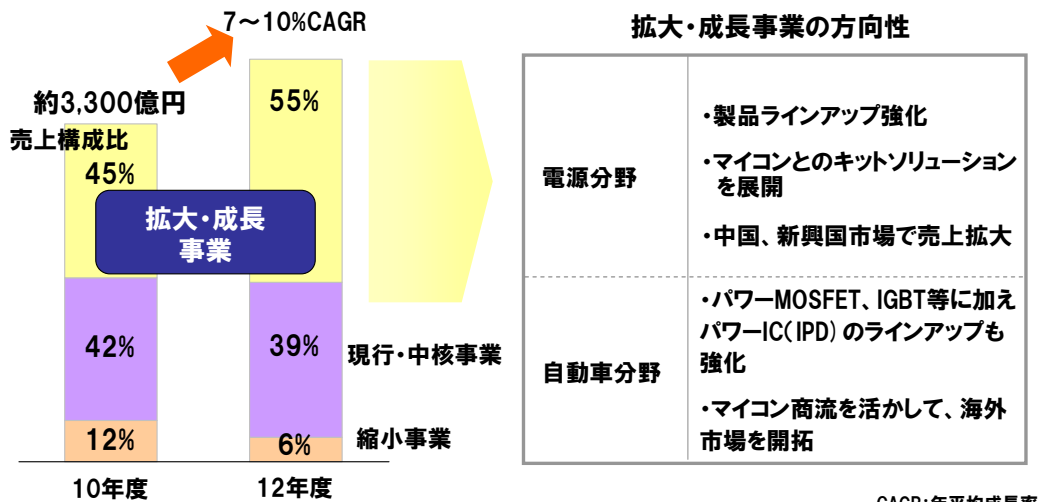
中国市場は電子機器において世界の生産基地から世界の消費地へと変化しつつ成長を続けています。この中国市場環境の変化に即応し、現地のニーズにあった製品の投入をタイムリーに行うため、当社は中国におけるマイコン事業の体制を強化します。

中国事業体制の強化として、10月1日から、現地人をトップにおき、中国上海にマーケティングから販売まで約150名の拠点を置き、現地で意思決定できる体制を発足します。更に中国向け製品開発の強化策として中国の現地の設計力を強化します。現在600名の設計リソースを順次拡大し、発足後、3年間で中国に特化した約1000製品を市場投入する予定です。

新製品の市場投入は、既に当社のマイコン実績があり、且つ今後の市場変化に則したターゲットセグメントを中心に順次投入していく予定です。

## 成長戦略の策定:A&P半導体事業

- 市場規模が大きく、かつ今後も拡大が見込める電源分野、自動車分野に注力
- アナログIC、パワーデバイス、光デバイスのキットソリューションを構築、ラインアップ強化
- マイコンの商流を活かしたソリューション提供により事業拡大を目指す（特に中国・新興国市場）



### 拡大・成長事業の方向性

電源分野	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製品ラインアップ強化</li> <li>・マイコンとのキットソリューションを展開</li> <li>・中国、新興国市場で売上拡大</li> </ul>
自動車分野	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーMOSFET、IGBT等に加えパワーIC(IPD)のラインアップも強化</li> <li>・マイコン商流を活かして、海外市場を開拓</li> </ul>

CAGR:年平均成長率

次にA&P半導体事業の成長戦略について説明いたします。

A&P半導体は市場が大きく且つ今後も成長が見込まれる電源分野及び自動車分野に注力します。

12年度には10年度比7パーセントから10パーセントの年平均成長を見込んでおり、その成長拡大はこの注力分野が牽引します。

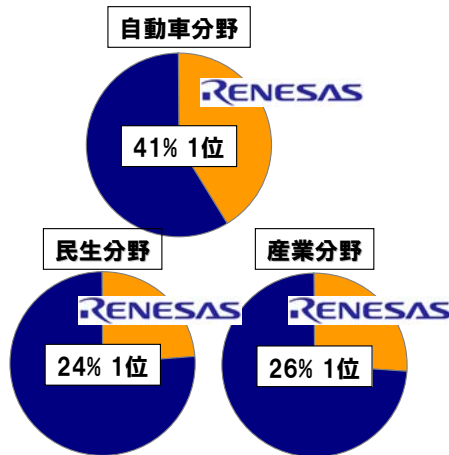
統合により製品ラインアップが強化されたアナログIC、パワーデバイスや光デバイスを更にキットソリューションとして顧客に提供することにより、統合シナジーを発揮し、個別2社の単純合算計画よりも高い売上成長を見込んでいます。

また、より強化されたマイコン事業の既存の顧客ネットワークを活用することにより、売上の拡大をはかります。

## 成長戦略の策定:マイコン事業とA&P半導体事業のシナジー

■ マイコン事業で培ったシステム力や顧客ウインドウを背景に、ラインアップ強化でアナログ・パワーデバイス事業を強化

マイコン分野別シェア(09年)



マイコンとA&P半導体キットソリューションの応用事例

分野	製品	キットソリューション応用事例
民生	家電・エアコン	IGBT+フォトカプラ+PFC-IC+マイコン
産業	産業インバータ応用(モータ)	IGBT+フォトカプラ+マイコン
自動車	自動車(HEV/EV)	IGBT+フォトカプラ+マイコン
産業	電池	パワーMOS+電池制御IC
産業	電力メータ	三端子レギュレータ+EEPROM+フォトカプラ+マイコン
民生	LED照明	パワーMOS+LEDドライバ+マイコン

注)各種調査に基づき、旧NECエレクトロニクスと旧ルネサステクノロジのシェアを合算

29ページでは、A&P半導体とマイコン事業とのシナジーについて説明いたします。

A&P半導体とマイコン事業の具体的なキットソリューションの事例として、

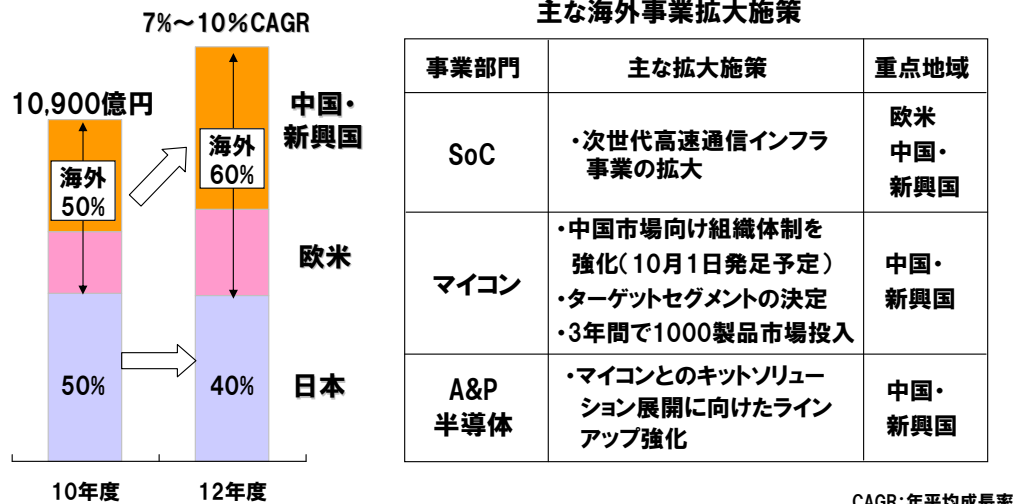
マイコンシェアW/WNO.1の民生分野においては、家電・エアコン、LED照明等にマイコンを核としてIGBTやフォトカプラ、高周波デバイスを組み合わせ、キットソリューションを提供します。

また、産業分野においては、今後の成長が見込まれる電源やスマートグリッド関係の市場への拡販としてマイコンを軸とし、IGBT、電源制御アナログICやフォトカプラ等をキットソリューションとして提供いたします。

更に、マイコンでダントツNO.1を誇る自動車分野においても、事業統合による更なるマイコンの強化を背景とした技術ノウハウや顧客ネットワークを活用し、A&P半導体とのキットソリューションを展開し売上拡大を図ります。

## 成長戦略の策定: 海外事業強化まとめ

- 12年度を目処に海外売上比率60%超へ
- 中国向けマイコン事業強化及びマイコンとアナログ&パワー半導体とのキットソリューションによる海外売上上の拡大
- 通信インフラ事業の強化による海外売上上の拡大



主な海外事業拡大施策		
事業部門	主な拡大施策	重点地域
SoC	・次世代高速通信インフラ事業の拡大	欧米 中国・新興国
マイコン	・中国市場向け組織体制を強化(10月1日発足予定) ・ターゲットセグメントの決定 ・3年間で1000製品市場投入	中国・新興国
A&P半導体	・マイコンとのキットソリューション展開に向けたラインアップ強化	中国・新興国

30ページは、海外事業の強化についてお示ししております。

これまで、各事業部門別に事業ポートフォリオの最適化の推進として、拡大・成長事業への取り組みを説明してきました。

それぞれの事業部門の成長戦略の結果として、当社の海外半導体売上比率は12年度を目処に約60%となる見込みです。

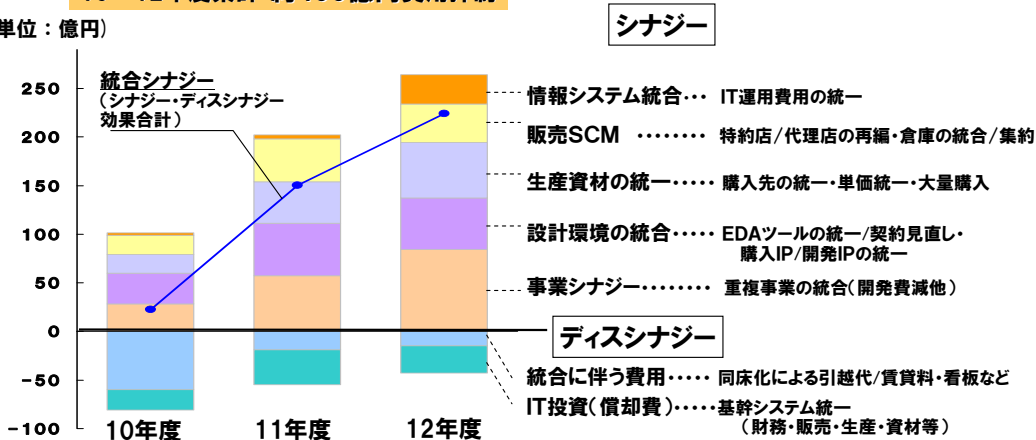
マイコン事業やA&P半導体事業における現地のニーズにあった製品の開発及びキットソリューションの提供、SoC事業における次世代高速通信インフラ事業の拡大を例とした、電子機器の多様化、融合化のニーズにあった技術基盤の提供を推進することにより、半導体売上全体として市場成長以上の成長を実現を目指します。

## 統合シナジーの実現：費用効果

### ■ 費用抑制の効果

10～12年度累計 約400億円費用抑制

(単位：億円)



### ■ 投資抑制の効果

生産性改善による売上増時の投資抑制

…生産技術の融合/標準化・生産系SCM統合・材料認定業務簡素化

10～12年度累計 約120億円抑制

31 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

31ページは、統合によるシナジー効果についてお示しております。

まず、統合による費用の抑制効果といたしましては、10年度から12年度の累計として約400億円を見込んでおります。

主なシナジー効果といたしましては、情報システムの統合、販売効率化、生産資材の統一、設計環境の統一などに加え、重複事業の統合等による事業シナジーがふくまれます。

一方、ディスシナジーとして、統合に伴う費用、基幹システムの統一などのIT費用も見込んでおります。

次に、統合による投資抑制効果といたしましては、10年度から12年度の累計として約120億円を見込んでおります。

これは、生産技術の統合や標準化など生産性の改善により、売上増が見込まれる状況においても投資を抑制することによって創出されるシナジー効果です。

## 統合シナジーの実現:国内特約店半減を含む販売チャネルの最適化

- 販売チャネルの再構築によるフロント販売力の強化
- 販売効率向上による販売経費の改善

### 狙い

- 力のある特約店、代理店を中心に販売チャネルの再編
- 1チャネルの規模増・集中化による販売力の強化
- 販売経費の削減
- 物流コストの削減

### 施策

- 特約店・代理店の再編
- 特約店との取引条件見直し
- 営業人員の効率化
- WW倉庫の統合、輸送費の見直し、包装材運用の統合

32ページは、販売効率化による統合シナジーです。

当社は、販売チャネルの再構築によりフロント販売力を強化するとともに、販売経費を改善させ、販売効率を向上させます。

施策の狙いとしましては、

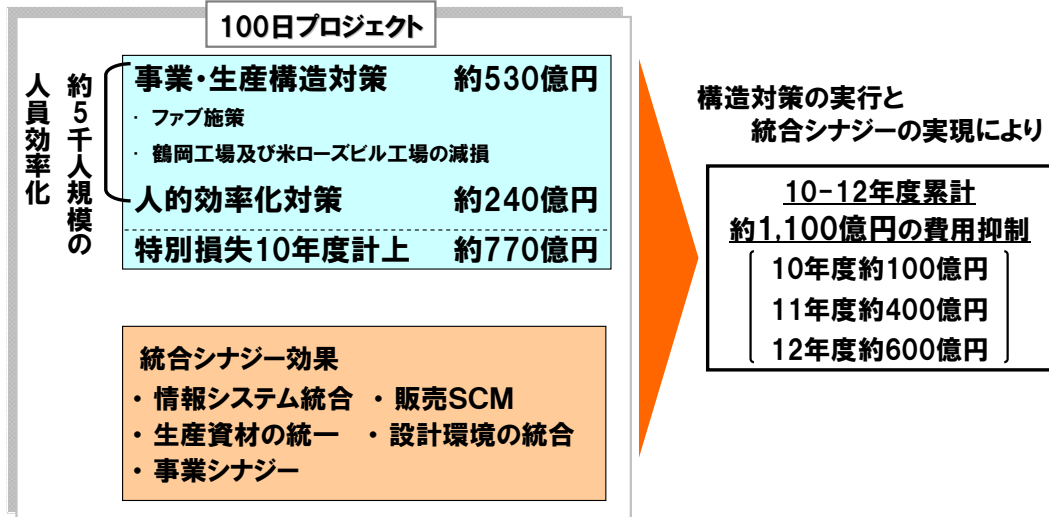
力のある代理店、特約店を中心に販売チャネルを再構築し、1チャネルあたりの規模を増大、集中化させることにより販売力の強化を図ります。また策定した施策により販売経費、物流コストの削減が見込まれます。

具体的な施策の内容としましては、

国内特約店半減を含む、特約店・代理店の再編、取引条件の見直し、また営業人員の効率化、倉庫の統合などが含まれます。

## 構造対策の実行

■ 市況変動に耐性があり、営業利益率2桁を実現する安定的成長を目指した根本的費用構造対策の推進



次に、構造対策の実行についてご説明いたします。

構造対策の実行といたしましては、安定成長を目指した根本的な費用構造対策として、主に生産構造対策と人的効率化がございます。

これらを実施することにより、今年度は、生産構造対策で約530億円、人的効率化で約240億円、合わせて約770億円の特別損失を計上する見込みです。

また、これらの施策により、12年度までに約5千人規模の人員効率化を図ります。

この構造対策を実施することにより、前述ご説明した統合シナジー効果と合わせ、10年度から12年度の累計で約1,100億円の費用抑制を想定しております。

## 構造対策の実行: ファブ施策

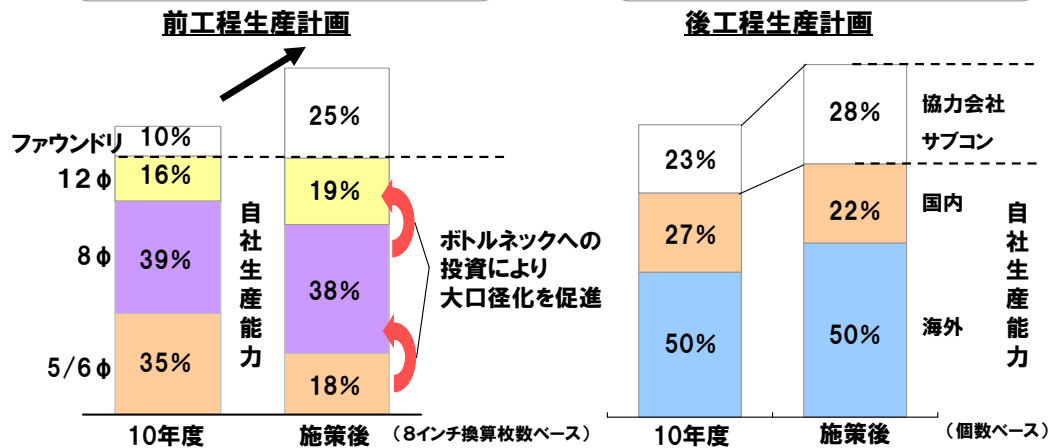
- 自社生産能力前工程は、大規模な増産投資を抑制し、生産効率化を推進
- 自社生産能力後工程は、海外での能力増強を推進

前工程

- ✓ 大口径化・微細化で生産効率向上
- ✓ 生産上振れ分は、先端を中心とした外ファブの活用を拡大
- ✓ 外ファブを含めたファブネットワークを構築し、製品の相互生産による稼働損リスクを軽減

後工程

- ✓ 自社生産能力は、海外での能力増強を推進
- ✓ サブコンとのファブネットワークの構築
- ✓ 協力会社・サブコンの効率化



34 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

まずは生産構造対策についてご説明いたします。

34ページにお示しておりますのは、前工程および後工程のファブ施策でございます。

当社は、外ファブを含めたファブネットワークの構築により、大規模な増産投資を抑制し、生産効率を推進します。

前工程につきましては、大口径化・微細化を進める生産効率の向上を推進します。生産上振れ分については、先端を中心に外ファブの活用を拡大してまいります。

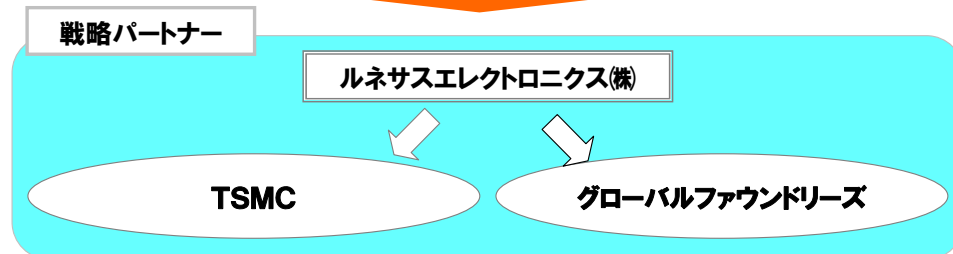
また、自社ファブ、外ファブを含めた最適なファブネットワークを構築し、製品の相互生産による稼働損リスクを軽減してまいります。

後工程におきましては、海外での能力増強を推進いたします。

またサブコンとのファブネットワークを構築することにより柔軟な生産体制を整えます。

## 構造対策の実行:先端プロセス事業の今後の方針

28ナノ以降の先端プロセス製品の量産は外部ファブ(ファウンドリ)に全面的に委託



- 鶴岡、那珂の300mmラインは、40nmまでのSoC製品と、今後微細化が進むマイコンの量産にフル活用
- 先端プロセスのR&Dは一本化して継続。
- 次世代以降を見通すプロセス要素技術についてはIBMとの共同研究を維持。

35ページは、先端プロセス事業の今後の方針についてお示しております。

当社は、28ナノ以降の最先端プロセス製品の量産は、戦略パートナーであるTSMC、グローバルファウンドリーズに全面的に委託することを決定いたしました。

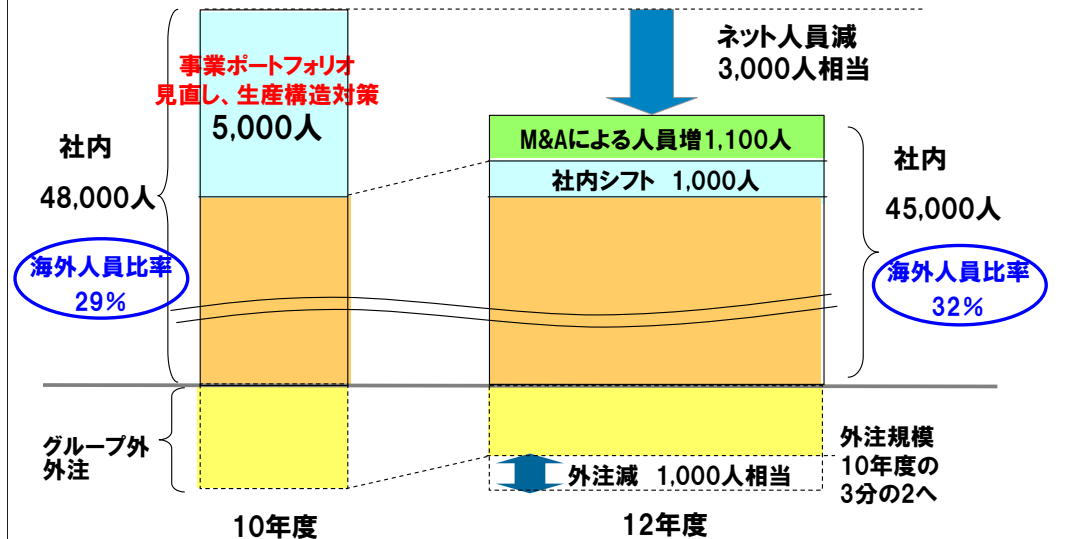
鶴岡および那珂の300ミリラインは、40ナノまでのSoC製品と、今後微細化が進むマイコンの量産に活用してまいります。

また先端プロセスの研究開発につきましては、旧NECエレクトロニクスと旧ルネサステクノロジの部隊を融合させ一本化し、継続して行っております。

次世代以降を見通すプロセスの要素技術につきましては、IBMとの共同研究を維持してまいります。

## 構造対策の実行:人的効率化対策

- 約5,000人規模の人的効率化対策を主に10年度に、更に12年度にかけて実施予定
- グループ外の外注を含めたトータル人的リソースを10%削減



36 © 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

次に人的効率化についてご説明いたします。

36ページにお示しておりますが、当社は約5,000人規模の人的効率化を、主に今年度中に実施いたします。

100日プロジェクトによる事業ポートフォリオの見直し、生産構造対策の結果、約5,000人相当の人的リソースは、社内シフト約1,000人、外注減約1,000人相当を含め、人員配置の最適化を進めます。

一方で、ノキア社ワイヤレスモデム事業買収による人員増、海外事業の強化、海外後工程の強化なども実施し、12年度までにグループ外の外注を含めた人的リソースを約10%削減いたします。

## IV. まとめ

最後に本日のまとめでございます。

## 経営目標

- **統合初年度より営業黒字を目指す**
- **必要な構造対策を統合の初期段階に集中して取り組み、2年目には当期黒字を目指す**
- **12年度までに磐石な経営基盤を構築し、中期的な営業利益率(売上高比)は2桁を目指す**

当社は、100日プロジェクトにおいてありとあらゆる経営課題を検討し、構造対策プランを策定いたしました。

これらを実行することにより、

統合初年度である今年度は営業黒字を目指します。

また必要な構造対策は、今年度を中心に集中して取り組み、来年度には当期黒字を目指します。

12年度までに磐石な経営基盤を構築し、中期的な営業利益率2桁を目指します。

The logo for Renesas, featuring the word "RENESAS" in a stylized, blue, sans-serif font. The letter "R" is unique, with a curved line extending from its top left.

ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

2011年3月期第1四半期の決算概要のご説明は以上でございます。  
本日は有難うございました。